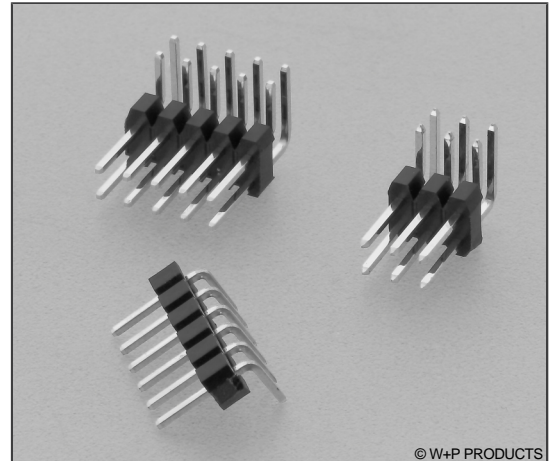


Stiftleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig – abgesetzter Isolierkörper Pin Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row – Offset Body

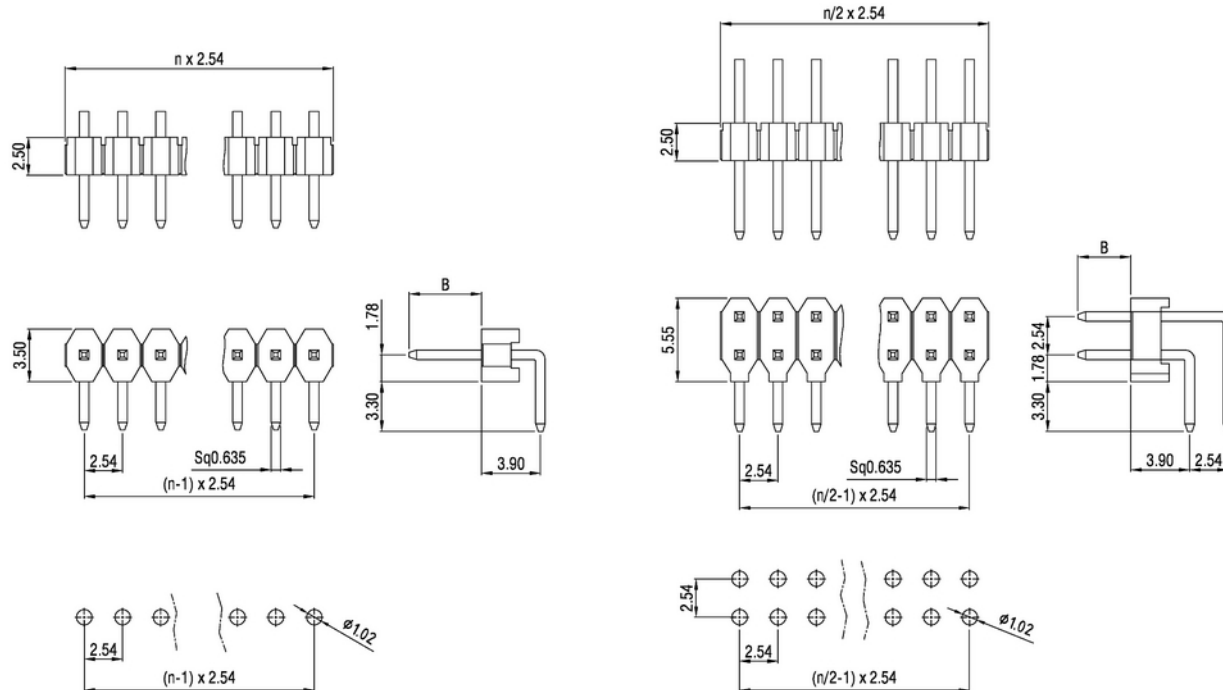
Technische Daten / Technical Data

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung |
| Contact Material | 0.635mm square pin, copper alloy |
| Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| Contact Surface | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm) |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Contact Resistance | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 1kV _{DC} |
| Test Voltage | 1kV _{DC} |
| Nennspannung | 250V _{AC} |
| Voltage Rating | 250V _{AC} |
| Nennstrom | 3A |
| Current Rating | 3A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +125°C |
| Temperature Range | -40°C ... +125°C |
| Verarbeitung | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren |
| Processing | Wave or reflow soldering |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
388 3882 etc.
Weitere siehe Kapitel B
→ ch. B for more



Series*

966

Gestanzte/geprägte Kontakte

Stamped/formed contacts

966 Einreihig

Single row

967 Zweireihig

Double row

Dimensions*

13

12 B=3,50mm

13 B=4,80mm

14 B=6,10mm

15 B=6,90mm

16 B=9,90mm

17 B=12,00mm

18 B=13,80mm

19 B=15,00mm

20 B=17,10mm

Contacts*

040

001-040 Einreihig

Single row

004-080 Zweireihig

Double row

Plating*

00

00 Vergoldet

Gold plated

50 Verzinkt

Tin plated

60 Sel. Au/Sn

Duplex plating

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bestellseite
"Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn.
Informationen.

More dimensions on request. Order page "Customer-
specific Pin Configurations" in Technical Information.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150°C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200°C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217°C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260°C ±5 |
| Dauer Höchsttemperatur | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P | Max. 8 min |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150°C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200°C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217°C |
| Duration above T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Peak Temperature T_P | 260°C ±5 |
| Duration Peak Temperature | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | Max. 8min |

